

2018



深科技非全日制硕士联合培养



使命、愿景、价值观

值得信赖
受人尊敬

使 命

提供优质的电子产品研发制造服务，为社会创造价值，为员工提供发展平台

愿 景

成为值得信赖并受人尊敬的企业

价 值观

团队合作 以人为本
追求卓越 勇于创新
诚实守信 共同发展
稳健财务 服务社会



公司简介



全球领先的**EMS**企业, 为客户提供**研发、制造、供应链、物流、系统解决方案**等全产业链服务



成立于**1985**年, **1994**年在深交所挂牌上市 (**000021.SZ**)



总部位于深圳福田区, 共**9**个生产基地, 逾**30,000**员工



国家**高新技术企业**, 2016年销售收入**150**亿元人民币



位列世界**EMS**企业前列



CEC集团核心企业之一, 中国**500**强企业, 深圳工业百强企业**12**位



中国电子信息产业集团

成立：1989年5月

注册资本：86.3亿人民币

销售收入：1950亿人民币 (2017)

世界500强企业：第362位 (2017)

员工人数：140,000



PANDA 群达



TPV
VISION INNOVATOR



光谷联合
OPTICS VALLEY UNION



中国·振华



桑达股份



SOLOMON
SYSTEM
崧门科技



IRICO



彩虹集团新能源股份有限公司
CAILONG GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED

中國電子集團控股有限公司

工厂布局

- SMT线体：160条
- 厂房面积：455,900 m²



美国NPI中心：2017年

- 厂房面积：1,000 m²
- 员工人数：待定



成都工厂：2016年

- 厂房面积：10,000 m²
- 员工人数：1,000



苏州工厂：2005年

- 厂房面积：70,000 m²
- 员工人数：1,600



惠州工厂：2013年

- 厂房面积：120,000 m²
- 员工人数：8,000



马来西亚工厂：2014年

- 厂房面积：9,500 m²
- 员工人数：800



东莞工厂：2015年

- 厂房面积：170,000 m²
- 员工人数：13,000



泰国工厂：2014年

- 厂房面积：2,000 m²
- 员工人数：100



菲律宾工厂：2017年

- 厂房面积：4,400 m²
- 员工人数：300



深圳工厂：1985年

- 厂房面积：50,000 m²(福田)+20,000 m²(石岩)
- 员工人数：3,000(福田) + 1,000(石岩)



全球布局



发展历程

1985-1995

磁头业务稳步发展

- 1985 - 深科技在深圳**蛇口**工业区成立，开始生产计算机**硬盘磁头**
- 1992 - 被认定为深圳市**高新技术企业**，迁至**福田彩田园区**
- 1994 - 在深交所正式挂牌**上市**

1996-2006

业务多元化发展

- 1996 - 导入**硬盘盘基盘**业务
- 1997 - 开始生产硬盘**薄膜磁头**
- 1998 - 意大利智能电表研发项目启动
- 2000 - 开启中国对意大利**第一个技术出口（智能电表）项目**
- 2003 - 正式启动与**Epson**合作项目
- 2003 - 成立**开发微电子MEC**，与**Kingston**开启固态存储模组产品生产制造合作
- 2005 - 与**Seagate**启动全面合作

2007-2017

业务多元化发展

- 2007 - 与**Samsung**签署合作协议生产手机
- 2009 - 与**ZTE**开启通讯业务合作生产手机与**Resmed**开始医疗产品生产制造业合作
- 2010 - **LED MOCVD**项目落户厦门
- 2012 - 与**Huawei**开启终端产品制造合作，生产智能手机及可穿戴产品
- 2015 - 收购**Payton**，导入半导体封装及测试业务，完成封测-模组整体制造链
- 2015 - 开始电子产品**维修服务**
- 2016 - 与**vivo**开启智能手机制造合作
- 2017 - 与**FPC**开启指纹识别封装的合作
- 2017 - 进入**无人机**生产制造领域

主要业务

计算机 & 储存

- 硬盘 PCBA
- 硬盘 HSA
- 硬盘 FPC
- 硬盘 基盘



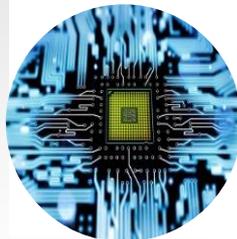
通讯电子 & 消费

- 智能手机
- 智能可穿戴
- 维修服务



半导体

- 记忆/指纹IC
- DRAM 模组
- 闪速储存器 (CF/SD/USB/SSD)



医疗器械

- 呼吸机
- MRI控制器
- 智能汤勺
- 智能血糖仪



汽车电子

- 无人机
- ABS 控制
- 导航系统
- 智能传感器



商业与工业

- 投影仪
- 新能源产品
- 小批量多品种产品



自动化

- 自动化设备
- 自动化解决方案



计量系统

- 智能电表
- 智能水表
- 智能气表
- 能源管理系统



工业物联网

- iDAS
- 静电监控系统
- IOT系统
- 实时定位系统



客户分布



管理体系



企业资源管理
系统



制造执行系统



六西格玛



产品生命周期
管理



平衡记分卡



企业业务流程
再造



卓越绩效管理



企业知识产权
管理

非全日制硕士联合培养招生政策

LAB联合培养专业需求

专业	研究方向	数量需求
微电子/物理（应用物理、半导体物理、凝聚态物理）/电子信息工程、电磁兼容	<ul style="list-style-type: none">● 微电子器件（失效分析、ESD）● 半导体/集成电路失效分析（失效分析、ESD）● 微电子制造（失效分析）● 电子制造（失效分析、可靠性）● 电磁兼容（可靠性）● 微电子可靠性（可靠性）● 失效物理（失效分析、ESD）	3

培养政策

第一年：签培养协议，在校学习，提供助学金；

第二年：签实习协议，在公司实习，储干培训、岗位培训、实习津贴、免费住宿、餐补等；

第三年：签劳动合同，在公司上班，工资及五险一金，住房补贴、餐补、享受法定员工假期等；

第四年：比企后签劳动合同三年，最低服务两年，否则按违约处理；毕业后按同期硕士储干标准执行。



成为值得信赖并受人尊敬的企业

Web: www.kaifa.cn Tel: +86-755-83032000 Email: contact@kaifa.cn



深科技000021



深科技



Shenzhen Kaifa Technology Co.,Ltd

